

Automotive UFS 검증을 위하여 다양한 SW Platform을 지원하는 Automotive Test Board를 소개합니다

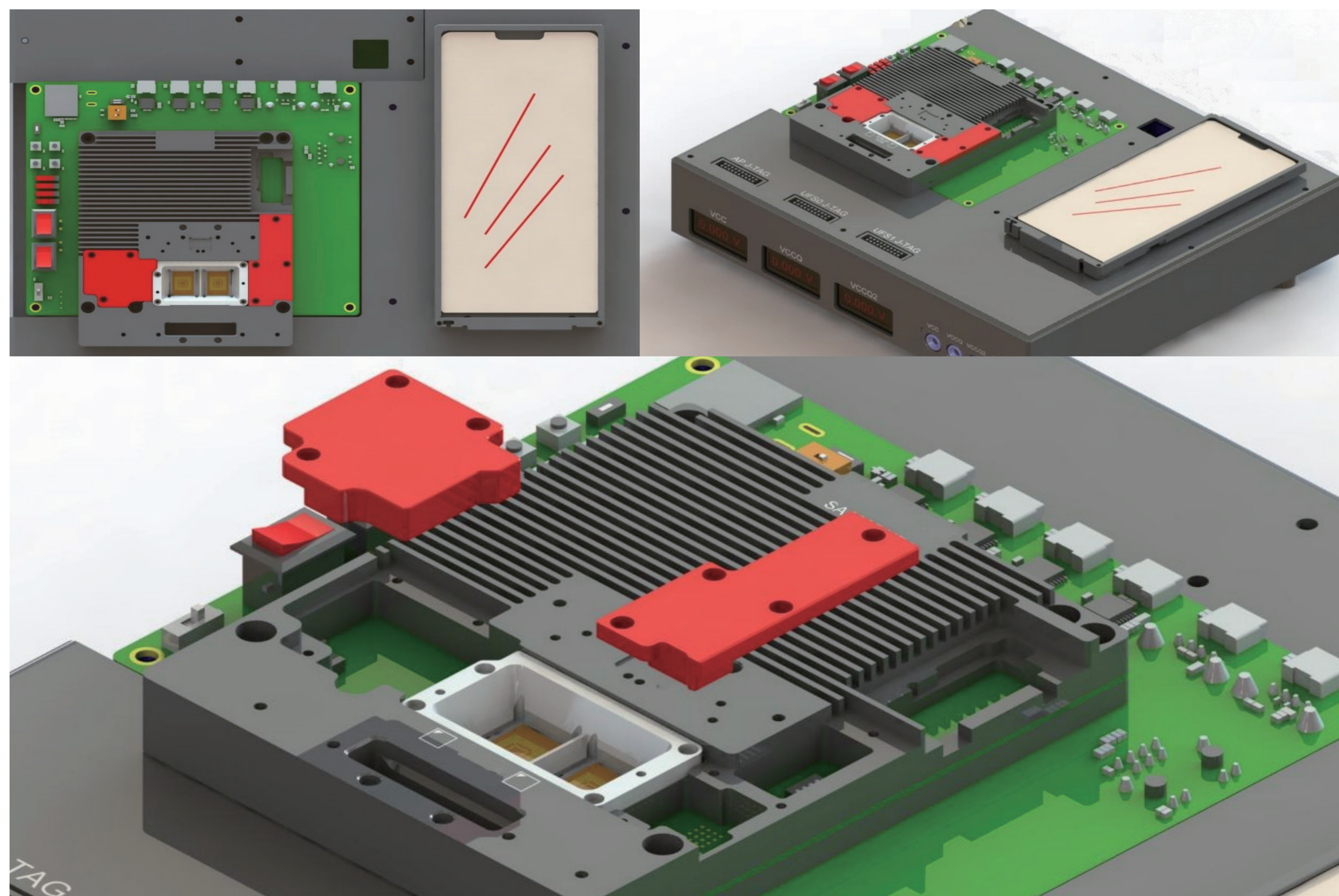


Automotive Memory의 조건

- 전장용 메모리 반도체 제품 생산을 위한 별도의 생산 프로세스 구축
- 차량용 메모리 반도체 업계의 온도 보증 구간인 -40°C~125°C의 특성 지원
- 전장용 반도체 신뢰성 시험 규격인 AEC-Q100 인증

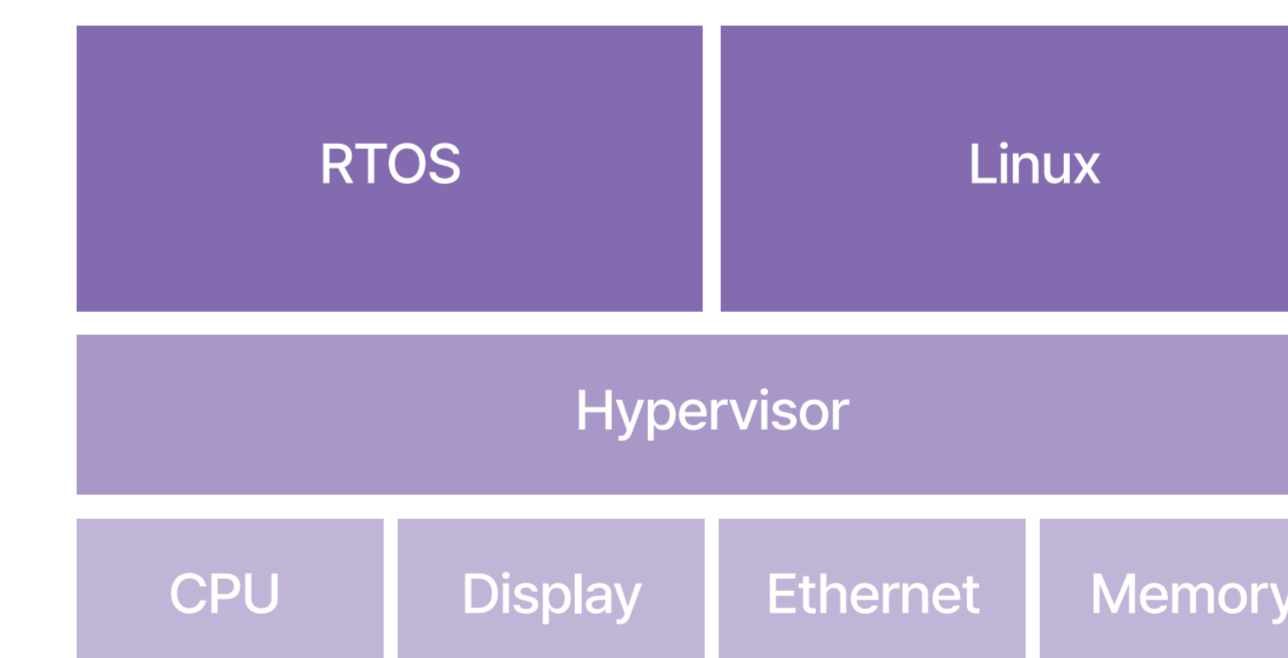
참고 URL : <https://news.skhynix.co.kr/post/blue-chips-in-self-driving-cars>

자동차에 탑재되는 메모리 솔루션은 스마트폰과는 다른 SW Platform과 인증 기준을 요구 하고 있습니다.
또한 IVI, ADAS 기능의 고도화로 점차 까다로운 인증 기준과 고용량, 고대역폭을 요구하고 있습니다.



고객사와 높은 정합성을 갖는 시스템

- Snapdragon® Cockpit Platform
- UFS 3.1 Gear4, 2-lane (x2)
- LPDDR4X
- Multi Display
- 1Gbps Ethernet
- BT/WIFI Connectivity
- USB 3.1 Gen 2



Hypervisor 기반의 Multi OS

메모리 특성 검증

- -40°C~125°C Temperature Control 지원
- Compact Size
- Multi UFS Test 지원
- Multi Host, Client 기반의 자동화 Test
- Multi Thread, Concurrent Workload 기반의 Test

HW

SW

Test Infra

* Snapdragon Cockpit Platform은 퀄컴 테크놀러지 Inc. 및/또는 자회사의 자산임

새로운 Feature Sets에 대하여 검증 기반을 마련하고, 고객사의 HW/SW Requirements 기반의 맞춤형 개발을 통해 Automotive 메모리 솔루션 제품 검증에 앞장서고 있습니다.